

2021-2027年中国半导体封装行业研究与投资战略研究报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

www.chinairr.org

一、报告报价

《2021-2027年中国半导体封装行业研究与投资战略研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/202108/09-421656.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: sales@chyxx.com

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。封装过程为：来自晶圆前道工艺的晶圆通过划片工艺后被切割为小的晶片（Die），然后将切割好的晶片用胶水贴装到相应的基板（引线框架）架的小岛上，再利用超细的金属（金锡铜铝）导线或者导电性树脂将晶片的接合焊盘（Bond Pad）连接到基板的相应引脚（Lead），并构成所要求的电路；然后再对独立的晶片用塑料外壳加以封装保护，塑封之后还要进行一系列操作，封装完成后进行成品测试，通常经过入检Incoming、测试Test和包装Packing等工序，最后入库出货。

集成电路封装测试包括封装和测试两个环节，封装是保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤，增强芯片的散热性能，实现电气连接，确保电路正常工作；测试主要是对芯片产品的功能、性能测试等，将功能、性能不符合要求的产品筛选出来。半导体封装和测试主要功能

主要功能	阶段	功能	简介
封装	电力传送	电子产品电力之传送必须经过线路的连接方可达成，可稳定地驱动IC。	信号传送
		信号，需透过封装层线路以送达正确的位置。	外界输入的
		将传递所产生的热量去除，使IC芯片不致因过热而毁损。	散热功能
能	避免受到外部环境污染的可能性。		保护功
晶圆测试	测试晶圆电性。		测试
测试IC功能、电性与散热是否正常。			成品测试

数据来源：公开资料整理

中国产业研究报告网发布的《2021-2027年中国半导体封装行业研究与报告》共十二章。首先介绍了半导体封装相关概念及发展环境，接着分析了中国半导体封装规模及消费需求，然后对中国半导体封装市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国半导体封装面临的机遇及发展前景。您若想对中国半导体封装有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章2015-2019年世界半导体封装行业发展态势分析

第一节2015-2019年世界半导体封装市场发展状况分析

中国台湾日月光公司居全球半导体封测行业第一名，市场占有率达18.90%。美国安靠、中国长电科技分居二、三位，分别占15.60%、13.10%。前十大封测厂商中，包含三家中国大陆公司，分别为长电科技、通富微电、华天科技。全球前十大封测企业占比超80% 数据来源：公开资料整理

一、世界半导体封装行业特点分析

二、世界半导体封装市场需求分析

第二节2015-2019年影响世界半导体封装发展因素分析

第三节2021-2027年世界半导体封装市场发展趋势分析

第二章中国半导体封装行业发展环境

第一节2019年中国宏观经济运行回顾

一、国内生产总值

二、社会消费

三、固定资产投资

四、对外贸易

第二节2019年中国宏观经济发展趋势

第三节2019年半导体封装行业相关政策及影响

一、行业具体政策

二、政策特点与影响

(一)全球市场形势不容乐观

(二)国内行业形势严峻

(三)国内政策环境不断改善

第三章中国半导体封装行业发展特点

第一节2015-2019年半导体封装行业运行分析

第二节中国半导体封装产业特征与行业重要性

一、在第二产业中的地位

二、在GDP中的地位

第三节半导体封装行业特性分析

一、投资风险庞大

二、相关人才相对缺乏

三、当地晶圆制造能力薄弱

第四节半导体封装行业发展历程

第五节半导体封装行业技术现状

一、注重新事物新技术的应用

二、实施标准化的优势

三、新型封装技术的应用

四、无铅焊接技术的采纳

五、关注倒装芯片技术的发展

六、集成电路封装技术国家工程实验室启动

第六节国内外市场的重要动态

一、封装材料销售额稳步增长

二、新技术推动材料产业发展

第四章中国半导体封装行业运行情况

第一节企业数量结构分析

第二节行业生产规模分析

第三节行业发展集中度

第四节2019年半导体封装行业景气状况分析

一、2019年半导体封装行业景气情况分析

二、行业发展面临的问题及应对策略

三、国际市场发展趋势

(一)封装形式向轻、薄、短、小发展

(二)封装技术日新月异

四、国际主要国家发展借鉴

第五章中国半导体封装行业供需情况

第一节半导体封装行业市场需求分析

一、行业需求现状

二、需求影响因素分析

第二节半导体封装行业供给能力分析

一、行业供给现状

二、需求供给因素分析

第六章2015-2019年半导体封装行业销售状况分析

第一节2015-2019年半导体封装行业销售收入分析

- 一、2015-2019年行业总销售收入分析
- 二、2015-2019年不同规模企业总销售收入分析
- 三、2015-2019年不同所有制企业总销售收入比较

第二节2015-2019年半导体封装行业投资收益率分析

- 一、2015-2019年按销售成本率分析
- 二、2015-2019年按销售费用率分析

第三节2019年半导体封装行业产品销售集中度分析

第四节2015-2019年半导体封装行业销售税金分析

- 一、2015-2019年行业销售税金分析
- 二、2015-2019年不同规模企业销售税金分析
- 三、2015-2019年不同所有制企业销售税金比较

第七章2015-2019年半导体封装所属行业进出口分析

第一节半导体封装历史出口总体分析

第二节影响半导体封装进出口的主要因素

- 一、半导体封装产品的国内外市场需求态势
- 二、国内外半导体封装产品的比较优势
- 三、半导体封装贸易环境的影响

第三节我国半导体封装出口量预测

第八章中国半导体封装行业重点区域运行分析

第一节2015-2019年华东地区半导体封装行业运行情况

- 一、华东地区半导体封装行业产销分析
- 二、华东地区半导体封装行业盈利能力分析
- 三、华东地区半导体封装行业偿债能力分析
- 四、华东地区半导体封装行业营运能力分析

第二节2015-2019年华南地区半导体封装行业运行情况

- 一、华南地区半导体封装行业产销分析
- 二、华南地区半导体封装行业盈利能力分析

三、华南地区半导体封装行业偿债能力分析

四、华南地区半导体封装行业营运能力分析

第三节2015-2019年华中地区半导体封装行业运行情况

一、华中地区半导体封装行业产销分析

二、华中地区半导体封装行业盈利能力分析

三、华中地区半导体封装行业偿债能力分析

四、华中地区半导体封装行业营运能力分析

第四节2015-2019年华北地区半导体封装行业运行情况

一、华北地区半导体封装行业产销分析

二、华北地区半导体封装行业盈利能力分析

三、华北地区半导体封装行业偿债能力分析

四、华北地区半导体封装行业营运能力分析

第五节2015-2019年西北地区半导体封装行业运行情况

一、西北地区半导体封装行业产销分析

二、西北地区半导体封装行业盈利能力分析

三、西北地区半导体封装行业偿债能力分析

四、西北地区半导体封装行业营运能力分析

第六节2015-2019年西南地区半导体封装行业运行情况

一、西南地区半导体封装行业产销分析

二、西南地区半导体封装行业盈利能力分析

三、西南地区半导体封装行业偿债能力分析

四、西南地区半导体封装行业营运能力分析

第七节2015-2019年东北地区半导体封装行业运行情况

一、东北地区半导体封装行业产销分析

二、东北地区半导体封装行业盈利能力分析

三、东北地区半导体封装行业偿债能力分析

四、东北地区半导体封装行业营运能力分析

第九章中国半导体封装行业SWOT

第一节半导体封装行业发展优势分析

第二节半导体封装行业发展劣势分析

第三节半导体封装行业发展机会分析

第四节半导体封装行业发展风险分析

第十章半导体封装行业重点企业竞争分析

第一节奇梦达科技(苏州)有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、经营状况
- 四、发展战略

第二节江苏新潮科技集团有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、经营状况
- 四、发展战略

第三节南通华达微电子集团有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、经营状况
- 四、发展战略

第四节英飞凌科技(苏州)有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、经营状况
- 四、发展战略

第五节深圳赛意法微电子有限公司

- 一、企业概况
- 二、竞争优势分析
- 三、经营状况
- 四、发展战略

第十一章未来半导体封装行业发展预测

第一节2021-2027年国际市场预测

- 一、2021-2027年半导体封装行业产能预测

二、2021-2027年全球半导体封装行业市场需求前景

三、2021-2027年全球半导体封装行业市场价格预测

第二节2021-2027年国内市场预测

一、2021-2027年半导体封装行业产能预测

二、2021-2027年国内半导体封装行业产量预测

三、2021-2027年全球半导体封装行业市场需求前景

四、2021-2027年国内半导体封装行业市场价格预测

五、2021-2027年国内半导体封装行业集中度预测

第十二章半导体封装行业投资战略研究

第一节半导体封装行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节对中国半导体封装行业品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、半导体封装行业实施品牌战略的意义

三、半导体封装行业企业品牌的现状分析

四、半导体封装行业企业的品牌战略

(一)要树立强烈的品牌战略意识

(二)选准市场定位，确定战略品牌

(三)运用资本经营，加快开发速度

(四)利用信息网，实施组合经营

(五)实施规模化、集约化经营

五、半导体封装行业品牌战略管理的策略

第三节半导体封装行业投资战略研究

一、2019年半导体封装行业投资战略

二、2021-2027年半导体封装行业投资战略

图表目录：

图表 1 2019年半导体封装行业在第二产业中所占的地位

图表 2 2019年半导体封装行业在GDP中所占的地位

图表 3 2015-2019年世界半导体封装材料市场规模及增长对比图

图表 4 2015-2019年我国半导体封装行业销售收入对比图

图表 5 国内封装测试企业地域分布情况

图表 6 2019年十大封装测试企业

图表 7 2015-2019年我国IC产量及增长对比图

图表 8 中国集成电路各产业链产值比重

图表 9 2015-2019年我国半导体封装行业销售收入

图表 10 2015-2019年我国半导体封装行业不同规模企业销售收入(亿元)

图表 11 2019年底我国半导体封装行业不同规模企业销售收入分布图

图表 12 2015-2019年我国半导体封装行业不同所有制企业销售收入(亿元)

图表 13 2019年底我国半导体封装行业不同所有制企业销售收入分布图

图表 14 2015-2019年我国半导体封装行业销售成本率

图表 15 2015-2019年我国半导体封装行业规模企业销售成本率增长趋势图

图表 16 2015-2019年我国半导体封装行业销售费用率

图表 17 2015-2019年我国半导体封装行业规模企业销售费用率增长趋势图

图表 18 2019年中国重点地区半导体封装行业销售集中度情况

图表 19 2015-2019年我国半导体封装行业销售税金

图表 20 2015-2019年我国半导体封装行业规模企业销售税金增长趋势图

图表 21 2015-2019年我国半导体封装行业不同规模企业销售税金(亿元)

图表 22 2019年我国半导体封装行业不同规模企业销售税金分布图

图表 23 2015-2019年我国半导体封装行业不同所有制企业销售税金(亿元)

图表 24 2019年我国半导体封装行业不同所有制企业销售税金分布图

图表 25 2015-2019年我国半导体封装出口量及增长对比图

图表 26 2021-2027年我国半导体封装出口量预测图

图表 27 2015-2019年华东地区半导体封装行业盈利能力对比图

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/202108/09-421656.html>